

Communiqué de presse

Résultats du 19^{ème} appel à projets du FUI

Un très bon cru Minalogic avec 9 projets sous le signe de « l'open innovation à la mode interpôles »

Sur les 9 projets retenus par le FUI, 8 ont capitalisé sur les synergies de compétences entre Minalogic et 13 autres pôles de compétitivité pour mettre au point des innovations produits couvrant des domaines d'applications très divers : transport, énergie, communications, internet des objets, mécanique/mécatronique.

Grenoble, le 7 avril 2015 - Minalogic, pôle de compétitivité mondial du numérique alliant la micro-nanoélectronique et le logiciel, se réjouit de compter 9 des projets qu'il a présentés parmi les sélectionnés du Fonds Unique Interministériel (FUI) dans le cadre du 19^{ème} appel à projets. Cette bonne nouvelle porte à 118 le nombre de projets du pôle soutenus par le FUI. Le budget R&D cumulé de ces 9 projets s'élève à 32,7 M€ ; ils recevront des subventions publiques de la part de l'Etat et des collectivités locales à hauteur de 13,4 M€.

Sélectionnés pour leur caractère innovant et l'activité économique qu'ils génèreront, ces projets associent entreprises et laboratoire de recherche ou un organisme de formation. Avec 95% des projets co-labellisés à 2 pôles ou plus, mais jamais sans avoir 2 fois la même combinaison de pôles pour les projets retenus, ce FUI consacre la valeur ajoutée des dynamiques interpôles pour faire émerger des innovations répondant à des enjeux de marché variés que seule l'alliance de compétences rend possible.

« Minalogic est très fier des résultats de cette 19^{ème} édition qui conforte l'engagement fort de nos équipes et l'efficacité de notre démarche d'open innovation pour faire émerger des projets toujours à la pointe de l'innovation », commente Isabelle Guillaume, Déléguée générale de Minalogic. « Le portefeuille de projets retenus est une belle illustration de la diversité des applications et des marchés pour lesquels les technologies numériques sont sources d'innovation ».

Présentation des 9 projets labellisés par Minalogic et retenus par le FUI :

Dans la catégorie « Technologies numériques et systèmes bienveillants »

❖ **Armature :**

Le projet porte sur la conception d'une **antenne miniature active 3D** utilisant les technologies de plastronique et d'électronique imprimée sur substrat souple, pour des équipements type « pagers » (bip) qui équipent les personnels du métier de sécurité civile en Europe (les pompiers) et certains industriels (SNCF, PME-PMI...). Ils se doivent d'être déclenchés par des réseaux privés dits « sécurisés » contrairement aux réseaux publics des opérateurs. Ce projet permettra de positionner une offre compétitive avec un produit innovant, conçu, industrialisé et assemblé en France.

Partenaires : **TPL Systèmes (24)**, PEP (01), Arc-En-Ciel Sérigraphie (42), CEA-Leti (38), CEA-Liten (38), S2P (01)

Budget total : 2 777 k€

Projet co-labellisé par les pôles Plastipolis et AeroSpace Valley

❖ **HMDE :**

L'objectif du projet est la mise au point de **solutions de gravures profondes innovantes** pour le développement de nouveaux composants en « matériaux durs » (saphir, verre, céramique, cristaux). L'innovation porte sur le développement de ces composants grâce à des structures 3D aux dimensions micrométriques non réalisables par les techniques classiques d'usinage (mécanique, gravure chimique). Deux familles de composants sont identifiées : des composants horlogers (roues, ressorts...) et des composants discrets RF plus compacts et plus performants pour les applications télécom (filtre, duplexeur...).

Partenaires : **Corial (38)**, Arnano (38), CEA (38), TDK EPCOS (06)
Budget total : 3 562 k€

❖ **INGOPCS :**

Les systèmes de contrôle-commande industriels et notamment ceux des Opérateurs d'Importance Vitale requièrent une amélioration significative de leur cybersécurité. Cette amélioration nécessite des logiciels sécurisés et les expertises associées. Le projet INGOPCS vise à développer une implémentation libre et sécurisée de la pile du protocole OPC-UA et à la vérifier grâce à des outils basés sur les méthodes formelles. L'ambition est de mettre à disposition du marché une implémentation logiciel libre de la pile support du protocole. Aucune implémentation sécurisée n'existe à ce jour, alors que l'usage de ce protocole de communication se répand de plus en plus dans le milieu industriel.

Partenaires : **Systemrel (92)**, Arc Informatique (92), Eolane (38), Trust in Soft (75), Atos Worldgrid (38), EDF (13), Schneider Electric (06), CEA (91), Telecom ParisTech (75)
Budget total : 4 763 k€
Projet co-labellisé par le pôle Systematic (chef de file)

❖ **lotize :**

Le projet loTize vise à **relier par des modules NFC les systèmes embarqués aux smartphones**. L'objectif de cette connexion est d'une part de bénéficier d'Interfaces Homme-Machine mutualisées et ergonomiques, et d'autre part d'apporter aux objets non connectés une passerelle vers l'Internet. Ces modules, faciles de mise en œuvre, s'adaptent aux applications existantes sans modification matérielle ou logicielle, par simple configuration et l'édition d'un fichier HTML.

Les premières cibles de loTize sont les PME et les ETI qui accéderont aux fonctions d'loTize sans développements lourds (Android, Internet). La recherche d'IHM de qualité correspond au marché des équipements, de l'instrumentation et de certains secteurs grand public comme la Maison Intelligente.

Partenaires : **Keolabs (38)**, ST Microelectronics (13), Gemalto (13), ISEN (83), LIG-INP (38)
Budget total : 3 824 k€
Projet co-labellisé par le pôle SCS (chef de file)

❖ **Prima :**

Développement de **nouveaux connecteurs magnétiques**, appliqués au transfert d'énergie électrique 12V et 220V.

Connecter et déconnecter des branchements est un geste du quotidien devenu banal qui peut s'avérer relativement complexe dans certaines situations et notamment par des enfants ou des personnes âgées (manque de force, d'agilité, sécurité). L'objectif du projet PRIMA est de développer un nouveau type de connecteur magnétique innovant, ainsi que sa technologie associée appliquée à la transmission de courant électrique avec les propriétés suivantes : guidage magnétique, sécurité électrique, intelligence du contact permettant la supervision et la gestion opérationnelle de la connexion. La mise en application sera faite dans 3 secteurs différents : l'électroménager, l'automobile et le chargement d'équipements industriels.



Partenaires : **ARaymond (38)**, Calor (38), gulplug (38), ADmajoris (69), Setup Performance (38), Fenwick (86), Renault (78), CNRS (38)
Budget total : 4 751 k€
Projet co-labellisé par le pôle : Plastipolis (chef de file)

Dans la catégorie « Procédés industriels et usines éco-efficiente »

❖ Arpe :

Le projet « ARPE » vise à **réduire très significativement le bruit des machines**, en particulier des pompes à vide utilisées dans la microélectronique, dans les marchés industriels (transport terrestre, aéronautique, défense, énergie, mécatronique...), dans la R&D et l'instrumentation analytique, qui représente un frein à leur utilisation à proximité des opérateurs. La démarche s'appuie sur le développement d'un logiciel et sa mise en œuvre sur un **prototype de pompe silencieuse**.

Partenaires : **adixen Vacuum Products (74)**, VIBRATEC (69), ECL/LTDS (69), INOPRO IAO, (38),
Budget total : 2 862 k€
Projet co-labellisé par les pôles Mont-Blanc Industries (chef de file) et Viaméca

❖ Ramgas :

Le projet RAMGas propose d'adapter une méthode optique existante d'analyse moléculaire d'un milieu liquide à **l'analyse de gaz**. L'objectif étant de mettre sur le marché un outil d'analyse complet accessible à des non-spécialistes, d'une grande fiabilité, afin de répondre aux exigences industrielles et à un prix compétitif. Les partenaires du projet s'appuient sur l'opportunité d'un mini spectromètre d'une performance inégalée, pour mettre au point un nouvel analyseur intégrant une sonde et un logiciel de pilotage complet.

Partenaires : **AP2E (13)**, Resolution Spectra System (38), IDEEL (69), Solvay (69), Arkema (69), Hubert Curien (Univ. St-Etienne) (42), IFPEN (69), Armines-Spin (42)
Budget total : 2 177 k€
Projet co-labellisé par les pôles Axelera (chef de file), CapEnergies et Optitec

Dans la catégorie « Technologies et systèmes de mobilité intelligents »

❖ Clima :

Le projet CLIMA (Conception de Liaisons Mécaniques Amortissantes) a pour objectif global de développer des assemblages mécaniques amortissants ainsi que des outils logiciels pour l'identification et la simulation de leur comportement dynamique. Le projet vise des cas d'application aéronautiques, notamment pour améliorer le confort vibratoire, le confort acoustique, mais aussi pour éviter, lors des phases de conception, des sur-dimensionnements, résultats d'une méconnaissance de ces zones critiques.

Partenaires : **Airbus Group Innovations (AGI) (92)**, ADR (77), Sopemea (78), Aderis (95), Avnir (75/69), Cedrat Technologies (38), SDTools (75), Texys (58), FEMTO-ST (25), Supméca (93)
Budget total : 4 145k€
Projet co-labellisé par le pôle ASTech (chef de file), le pôle des microtechniques et le pôle de l'industrie nucléaire

Dans la catégorie « Sports, tourisms et aménagements de montagne »

❖ Sécur'Sport :

Le projet Sécur'Sport vise à développer "AirFibr Connect" une technologie de surface sportive performante, sûre et connectée pour la pratique du football et du rugby. Innovante par ses propriétés mécaniques, cette surface permettra d'assurer aux pratiquants performance et sécurité. Connectée, cette surface garantira une performance optimale du terrain dans le temps, et permettra un suivi longitudinal des sportifs.

Cette technologie sera basée sur deux innovations majeures :

- La mise au point d'une technologie de surface de jeu optimale pour la performance et la santé du joueur, validée par l'étude des interactions biomécaniques sol-joueur
- Une technologie de monitoring en continu de l'évolution du comportement mécanique du sol, par l'instrumentation du pied du sportif.

Partenaires : **Natural Grass (75)**, Cityzen Sciences (69), CEA LETI, LIST, et LITEN (38), FeetMe (78),

Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak, (Arts et Métiers ParisTech) (75)

Budget total : 3 869 k€

Projet co-labellisé par les pôles Cap Digital (chef de file), Advancity

À propos de Minalogic –

Pôle de compétitivité mondial du numérique alliant la micro-nanoélectronique, le logiciel et désormais l'optique-photonique, Minalogic accompagne les porteurs d'innovation, petits et grands, dans leurs projets. Ce réseau de partenaires spécialisé active la rencontre des innovateurs, des industriels et des financeurs pour porter collectivement une technologie jusqu'à son marché. En assurant la cohésion du triangle industrie-recherche-formation au plan régional et son rayonnement au rang mondial, Minalogic s'impose comme un acteur incontournable de la région Rhône-Alpes.

Minalogic en bref :

- Plus de 300 membres, dont :
 - 270 entreprises, dont 89% de PME & ETI
 - 16 centres de recherche et universités
 - 15 collectivités territoriales
 - 16 organismes de développement économique et autres organisations
 - 2 investisseurs privés

397 projets financés à hauteur de 768 millions d'euros de subventions publiques et dont l'enveloppe globale de R&D représente plus de 2 milliards d'euros

www.minalogic.com - Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic

Contacts presse, ComCorp

Claire Flin, Muriel Martin - 01 58 18 32 54 / 06 82 92 94 47 - mmartin@comcorp.fr / cflin@comcorp.fr